

Direkt Palladium/Gold (EPAG) auf Kupfer – die neue Oberfläche für anspruchsvolle Elektronik / Teil 2

PRODUCT
Image
Unavailable



Die neue Leiterplattenoberfläche EPAG (Electroless Palladium, Autocatalytic Gold) betritt voraussichtlich im 3. Quartal 2014 den Leiterplattenmarkt und wird dann kommerziell erhältlich sein. Die Erstinstallation erfolgt bei der APL Oberflächentechnik GmbH in Lörrach. EPAG wird von Atotech unter dem Handelsnamen Palla-Bond vertrieben. In der Maiausgabe wurde über die Gründe für die Entwicklung der PallaBond (EP/EPAG)-Oberfläche und den Einsatz bei der Firma APL berichtet. Zudem wurden erste Ergebnisse zum Thema Bonden, Thermokompressions-Bonden, Feinstleiter, Hochfrequenz und Löten auf der PallaBond-Oberfläche gezeigt. Im zweiten Teil wird über die Eignung der PallaBond-Oberfläche für Flex-Leiterplatten, die Oberflächentopografie, die Härte, die Porosität, die Schichtdickenverteilung von Palladium und von Gold sowie über die Vorteile des PallaBond-Prozesses berichtet.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)